

平成20年3月期 中間決算説明会

平成19年11月14日

株式会社ジーダット



1.平成20年3月期 中間決算概要

2.平成20年3月期（通期）業績予想

3.今後の事業方針

平成20年3月期 中間決算概要(連結)

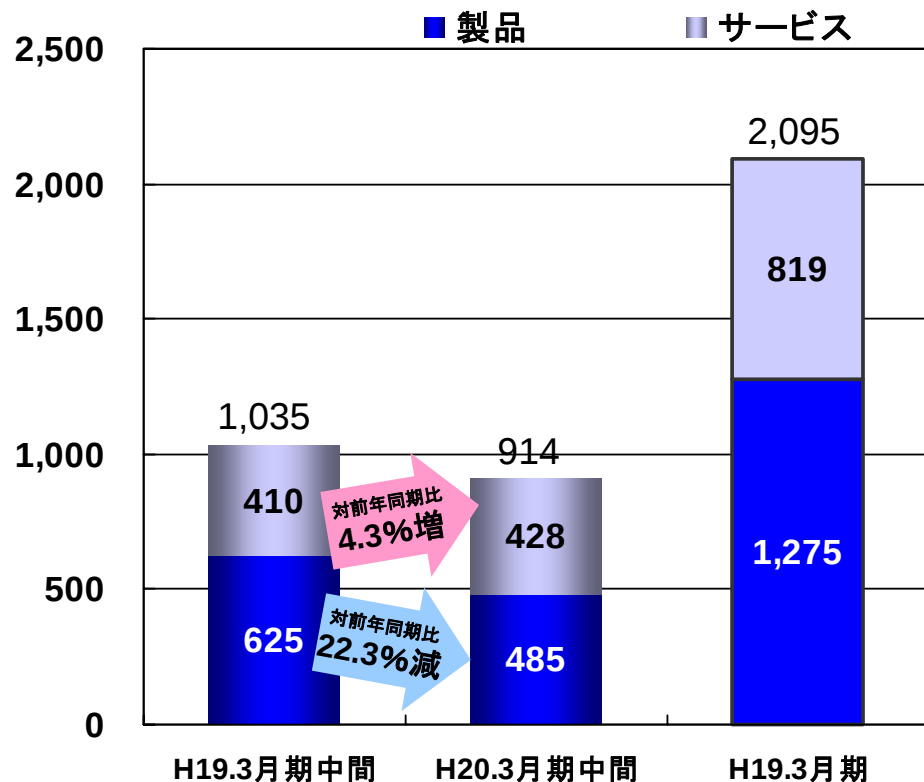
(単位:百万円)

	平成19年3月期 中間		平成20年3月期 中間			平成19年3月期	
	実績	売上高比	実績	売上高比	対前年 同期比	実績	売上高比
売上高	1,035	100.0%	914	100.0%	△11.8%	2,095	100.0%
売上総利益	759	73.3%	619	67.8%	△18.4%	1,473	70.3%
販売費及び 一般管理費	588	56.8%	594	65.0%	1.0%	1,266	60.4%
営業利益	171	16.5%	25	2.8%	△85.1%	207	9.9%
経常利益	220	21.3%	71	7.8%	△67.6%	290	13.9%
当期純利益	144	13.9%	46	5.1%	△67.5%	189	9.0%

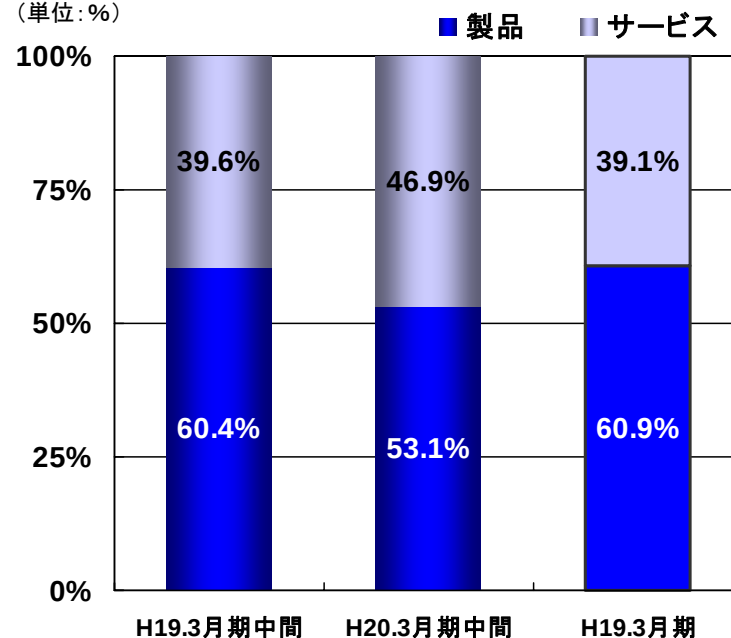
事業別売上高の推移(連結)

【製品/サービス別】

(単位: 百万円)



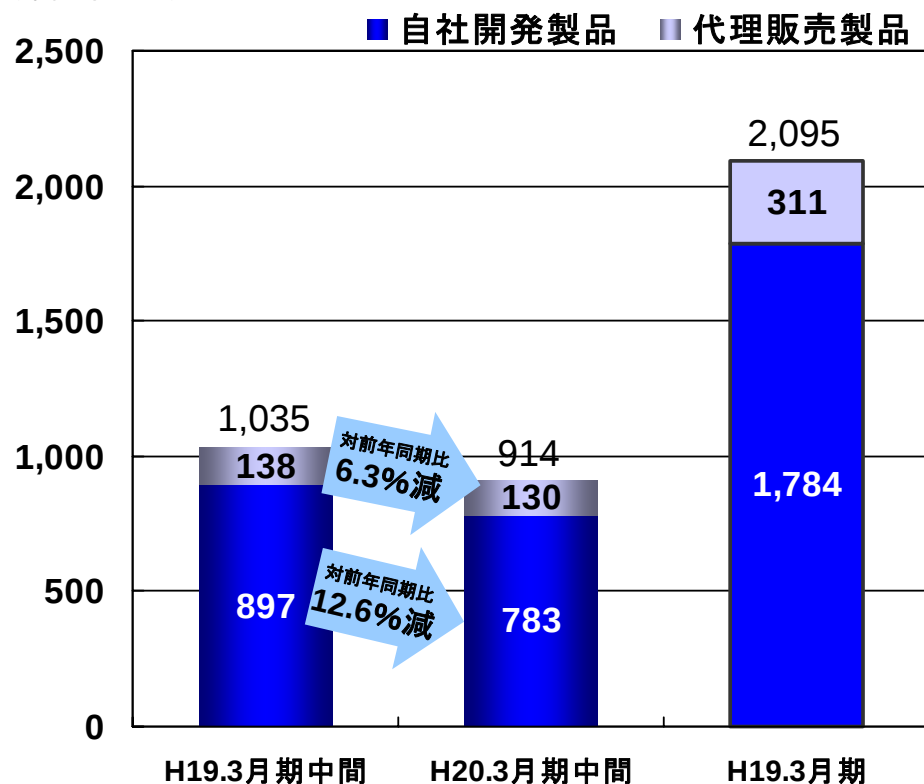
(単位: %)



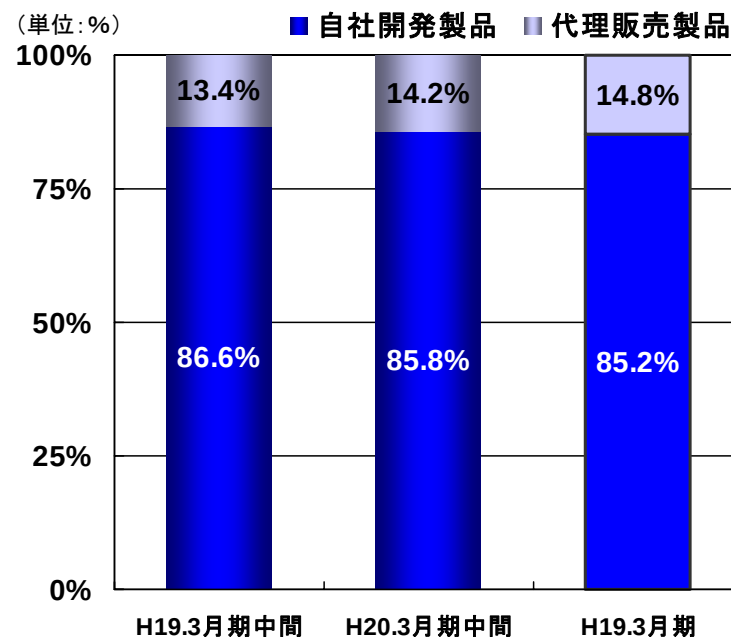
事業別売上高の推移(連結)

【自社開発製品/代理販売製品別】

(単位: 百万円)



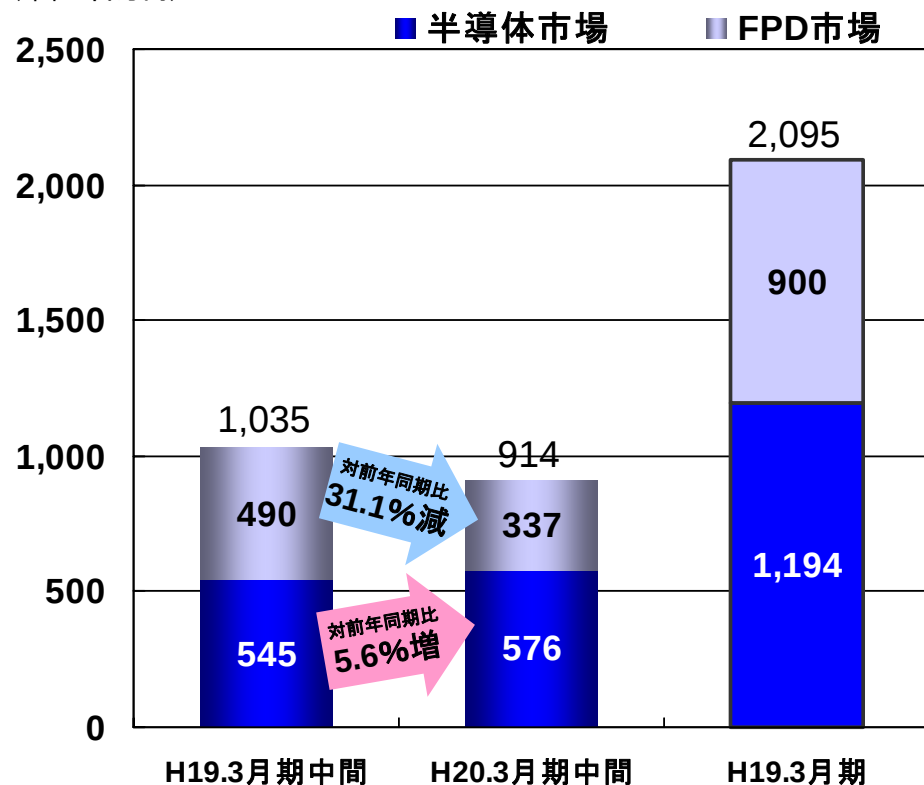
(単位: %)



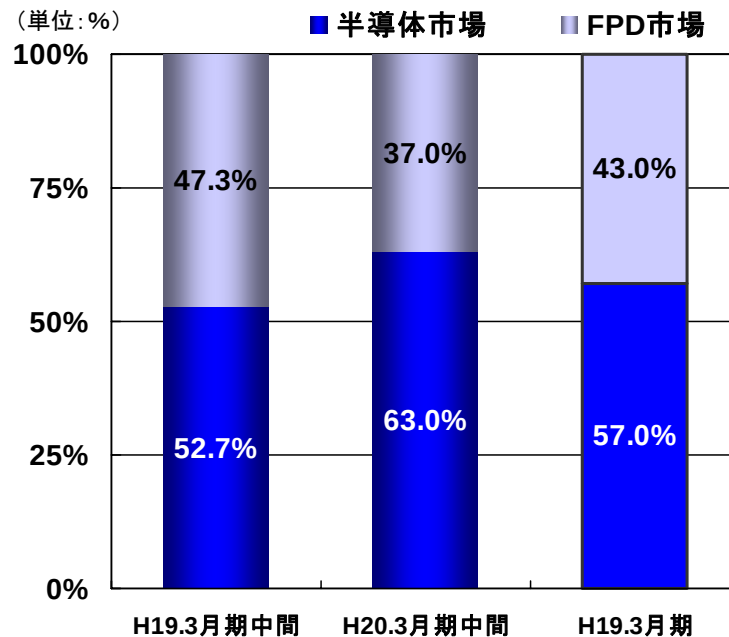
事業別売上高の推移(連結)

【半導体市場/FPD市場別】

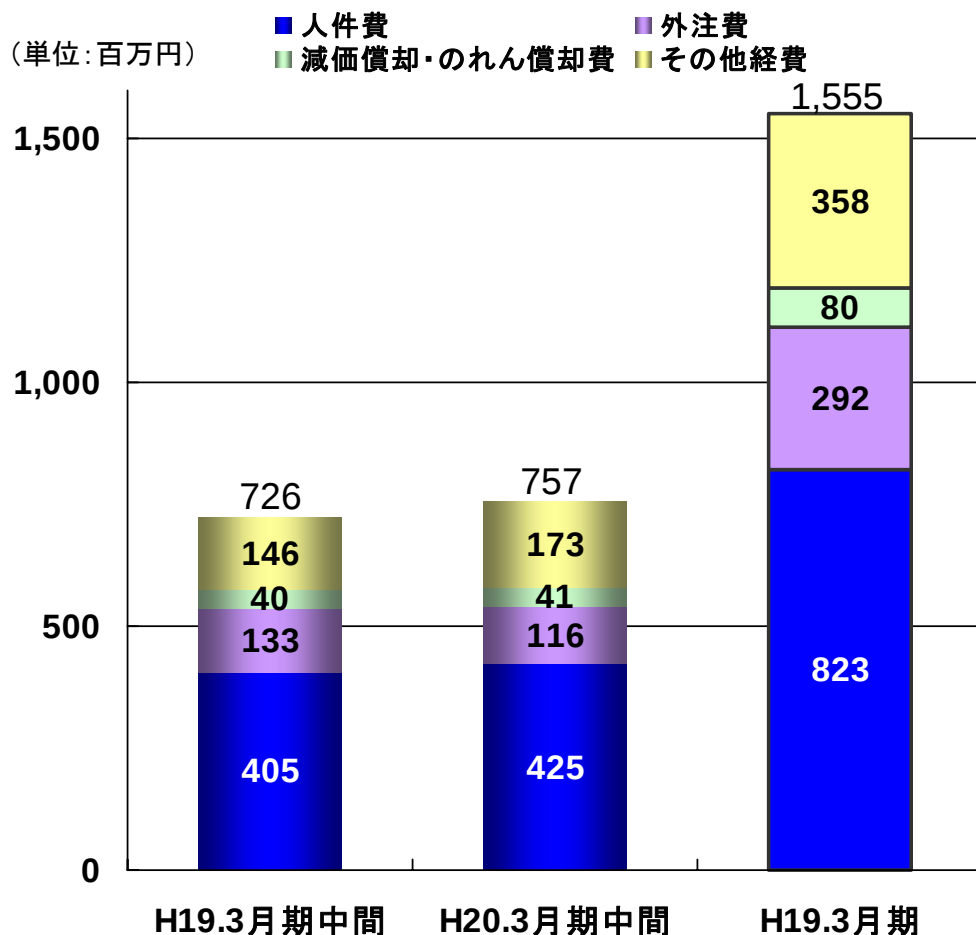
(単位: 百万円)



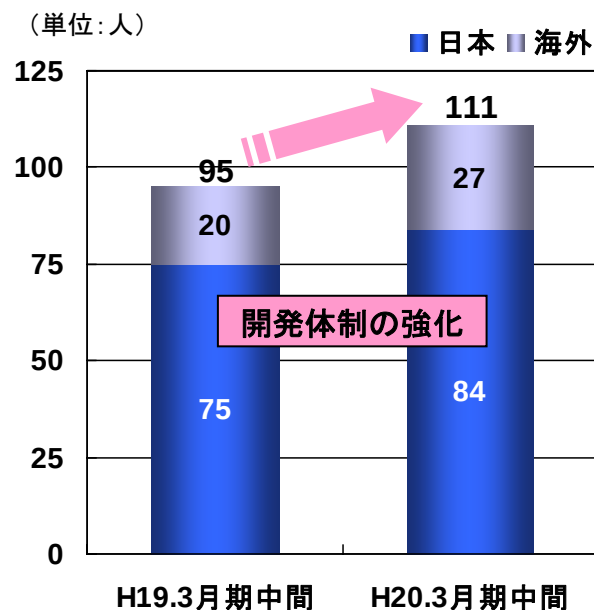
(単位: %)



固定費内訳推移(連結)

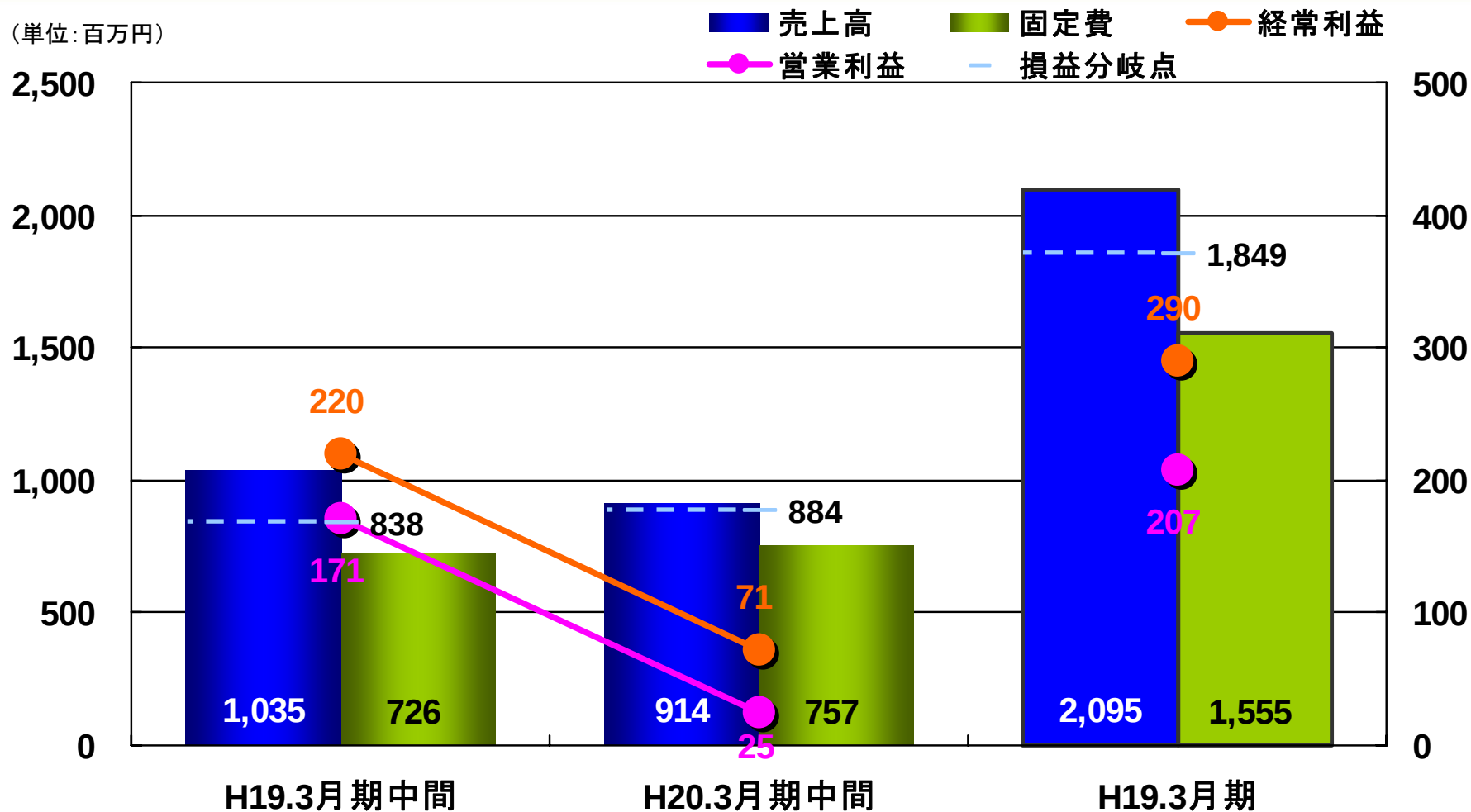


【中間期末要員数】



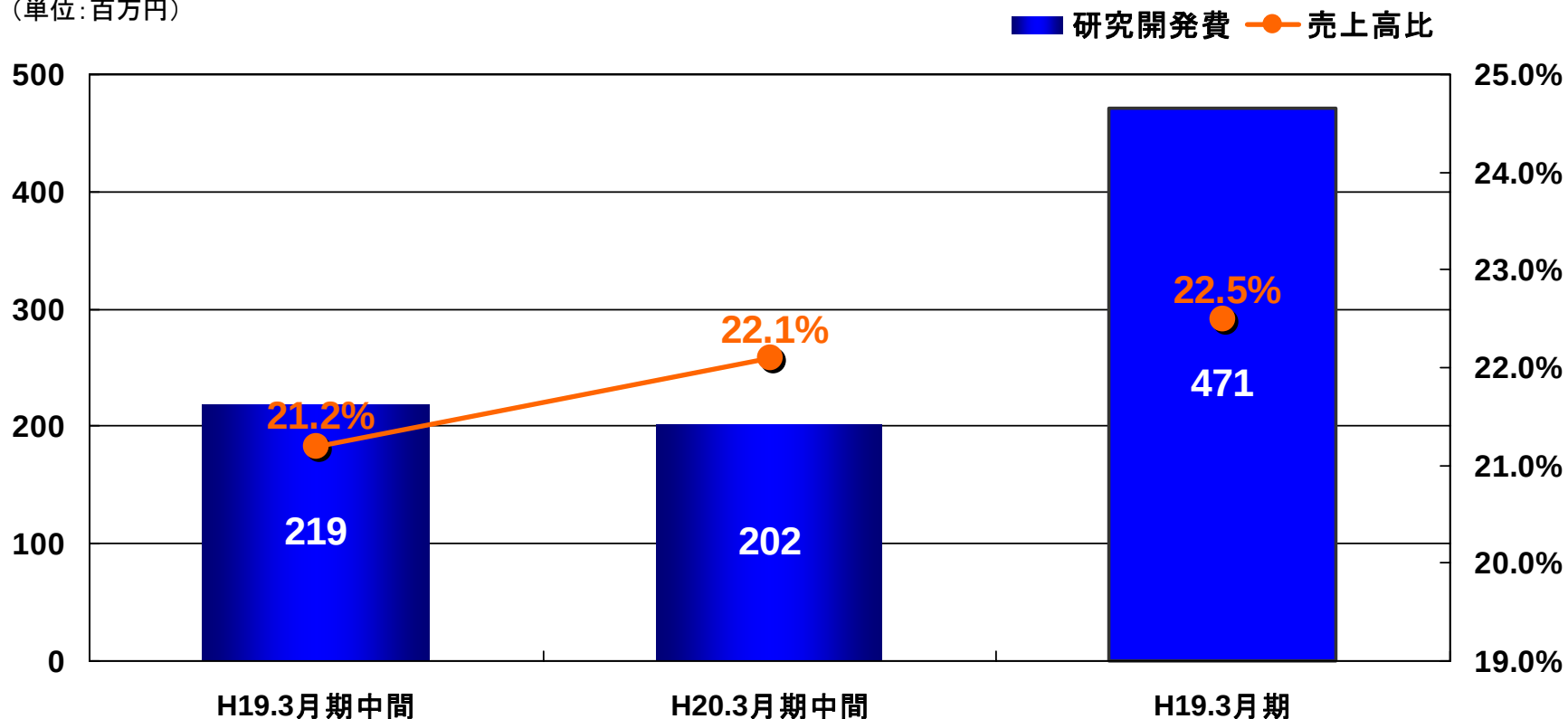
売上・利益の推移

(単位: 百万円)



研究開発費の推移

(単位:百万円)



アナログ設計分野 研究開発
DFM分野 研究開発

中間連結貸借対照表

(単位: 百万円)

	平成18年 9月30日	平成19年 9月30日	差異		平成18年 9月30日	平成19年 9月30日	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,011	1,663	△348	I 流動負債	534	455	△79
1 現金及び預金	1,388	1,138	△249	1 買掛金	86	69	△16
2 受取手形及び売掛金	413	389	△24	2 未払法人税等	97	31	△66
3 たな卸資産	18	15	△2	3 賞与引当金	85	78	△6
4 その他	191	119	△71	4 前受金	177	207	29
				5 その他	87	69	△18
				負債合計	534	455	△79
II 固定資産	308	1,100	792	(純資産の部)			
1 有形固定資産	16	21	5	I 株主資本	1,783	2,310	526
2 無形固定資産	110	43	△66	1 資本金	527	760	232
(1) のれん	107	35	△71	2 資本剰余金	658	890	232
(2) ソフトウェア	2	7	5	3 利益剰余金	597	660	62
3 投資その他の資産合計	181	1,035	853	II 評価・換算差額等	1	△2	△4
				為替換算調整勘定	1	△2	△4
				純資産合計	1,785	2,307	522
資産合計	2,320	2,763	443	負債純資産合計	2,320	2,763	443

米国 TAKUMI社の出資: 115百万円
長期性預金への預入: 700百万円

公募増資による新株発行(H19年3月15日): 464百万円
自己資本比率: 77.0%⇒83.5%

中間連結キャッシュフロー計算書

(単位: 百万円)

	平成18年4月1日 ～ 平成18年9月30日	平成19年4月1日 ～ 平成19年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	226	76	△149
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△2	△827	△824
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	546	△29	△575
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	1	1
V 現金及び現金同等物の増減額	770	△778	△1,549
VI 現金及び現金同等物の期首残高	617	1,917	1,299
VII 現金及び現金同等物の中間期末残高	1,388	1,138	△249

平成20年3月期 上半期トピックス

1. 米国TAKUMIとの業務および資本提携

(1) 目的

DFM分野の製品ラインナップ、ソリューションの強化

(2) 提携内容

業務提携: Takumi社製品の日本国内の販売代理店

資本提携: Takumi社に\$1Mの投資を実施

(両社の将来的な技術交流を視野に入れ、関係をより強固にする狙い)

Jedat社の既取扱製品

- ▶ **CMP-Designer**
(自社開発のCMP*シミュレータ)
- ▶ **HOTSCOPE**
(大日本印刷株式会社製DFM*ビューワ)
- ▶ **EYES/PEYE**
(英国Predictions Software Ltd.社製
歩留まり解析ツール)



Takumi社との提携

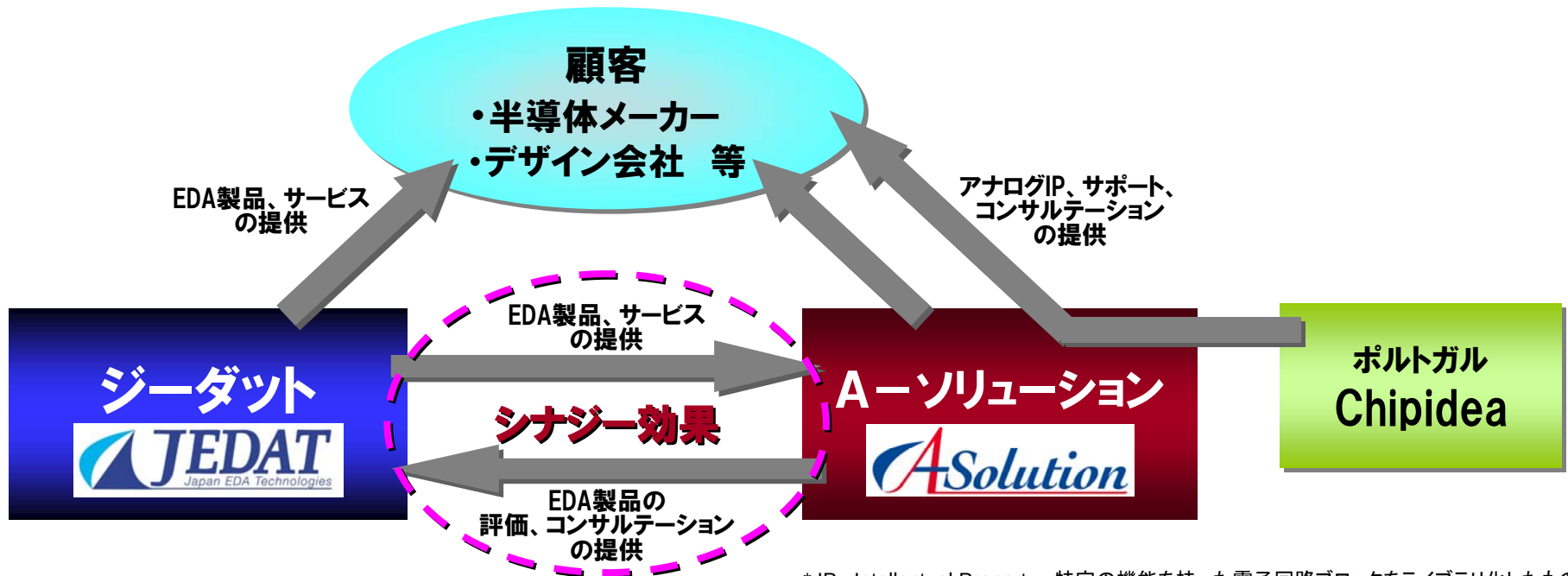
- ▶ **ホットスポットの自動解消による、歩留まり向上と早期量産化**
ホットスポット*自動解消機能
- ▶ **マスク製造手戻りの削減による、開発期間とコストの大幅削減**
マスク欠陥解析機能

* DFM : Design For Manufacturability , 半導体製造の事を考慮した設計手法／設計ツール
* CMP : Chemical Mechanical Polishing , 半導体の製造プロセスの1つ、化学的機械的研磨技術
* ホットスポット : 半導体製造時に欠陥となる可能性が高い危険箇所

平成20年3月期 上半期トピックス

2. 100%出資子会社Aーソリューション社の設立と、 ポルトガルChipidea社との業務提携

- (1) 目的: アナログIP分野への進出
- (2) 概要: アナログIPの開発、販売、サポート、コンサルテーション
Chipidea社のアナログIPの販売、技術サポート



* IP : Intellectual Property , 特定の機能を持った電子回路ブロックをライブラリ化したもの

1.平成20年3月期 中間決算概要

2.平成20年3月期 (通期)業績予想

3.今後の事業方針

平成20年3月期 業績予想(連結)

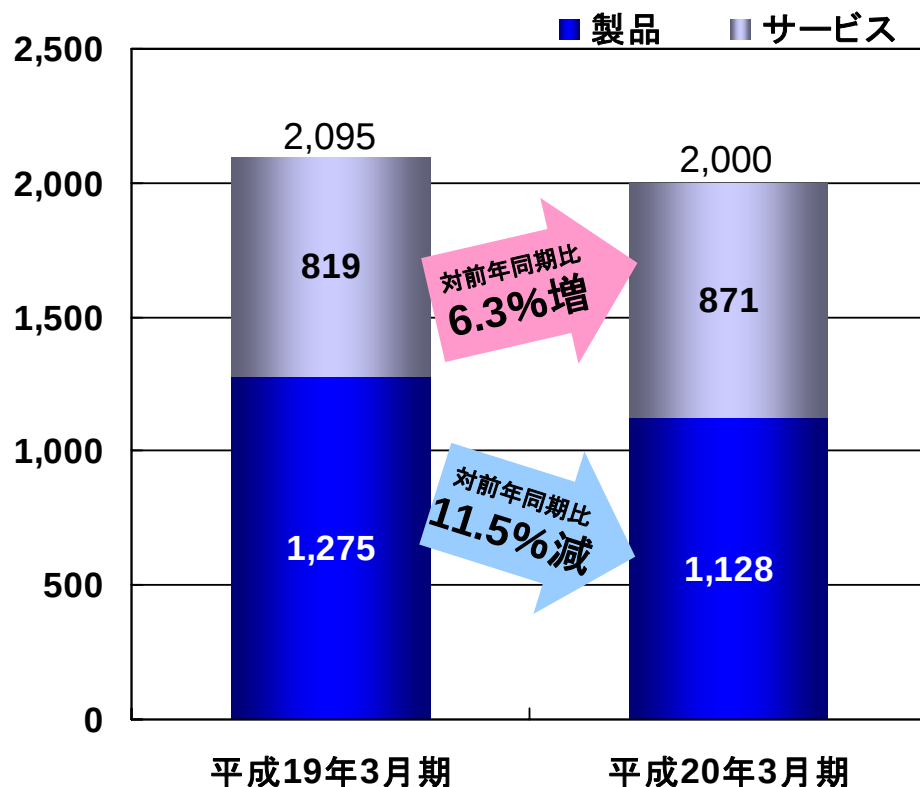
(単位:百万円)

	平成19年3月期業績		平成20年3月期業績予想		
	実績	売上高比	予想	売上高比	対前年同期比
売上高	2,095	100.0%	2,000	100.0%	△4.6%
売上総利益	1,473	70.3%	1,367	68.4%	△7.2%
販売費及び 一般管理費	1,266	60.4%	1,278	63.9%	+1.0%
営業利益	207	9.9%	89	4.5%	△56.8%
経常利益	290	13.9%	150	7.5%	△48.5%
当期純利益	189	9.0%	90	4.5%	△52.0%

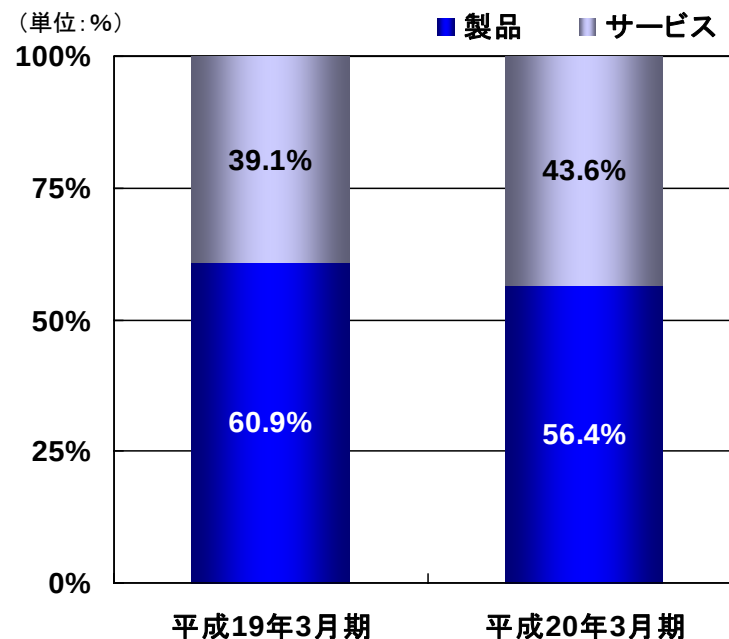
事業別売上高の推移(連結)

【製品/サービス別】

(単位:百万円)



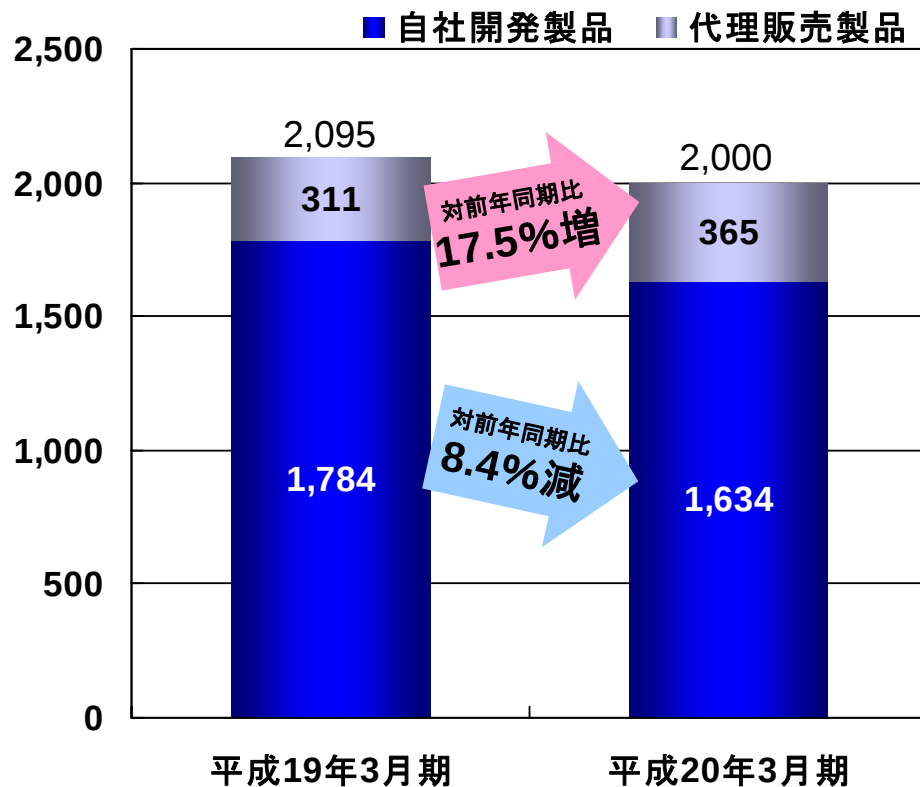
(単位: %)



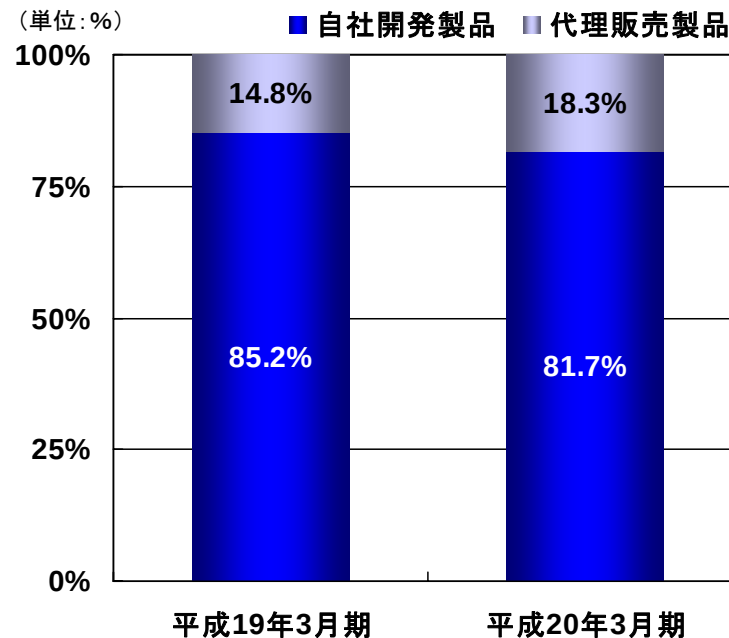
事業別売上高の推移(連結)

【自社開発製品/代理販売製品別】

(単位:百万円)



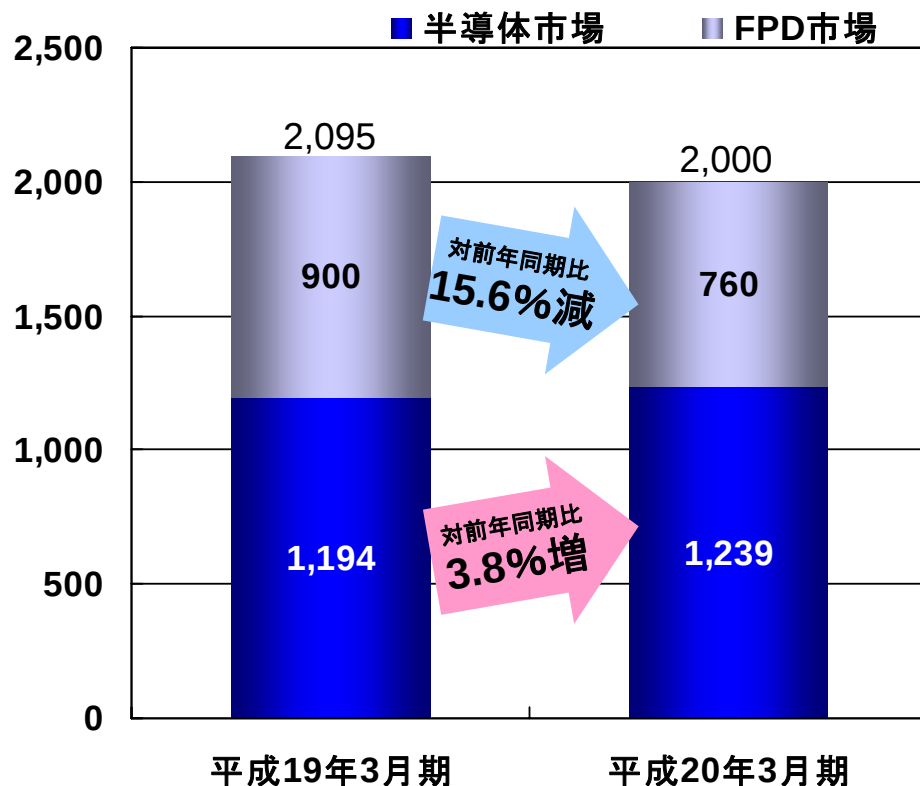
(単位: %)



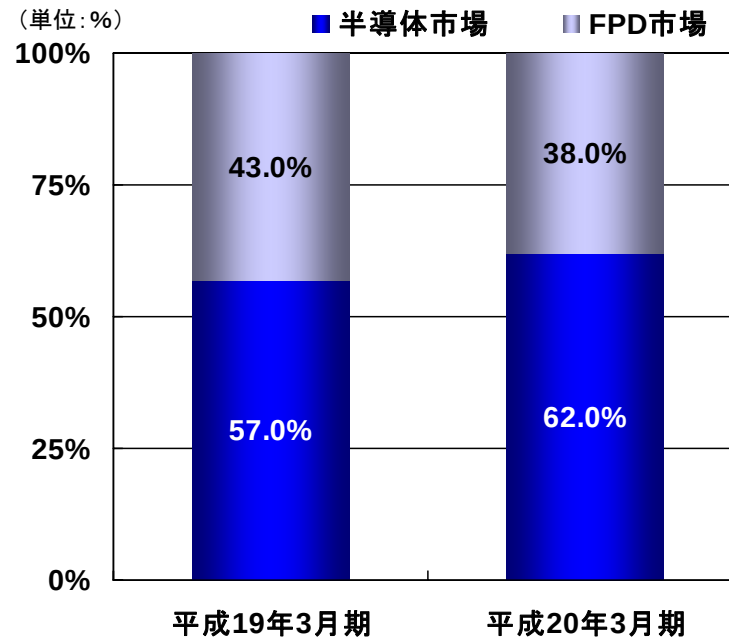
事業別売上高の推移(連結)

【半導体市場/FPD市場別】

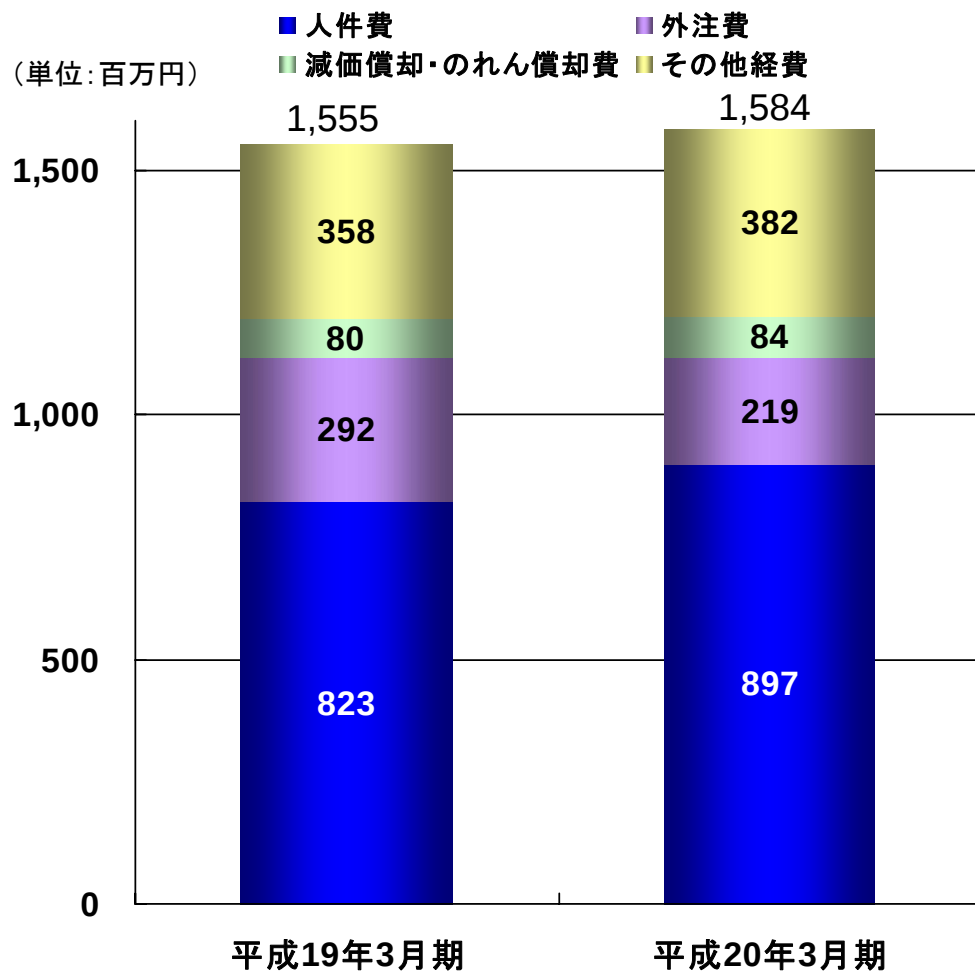
(単位:百万円)



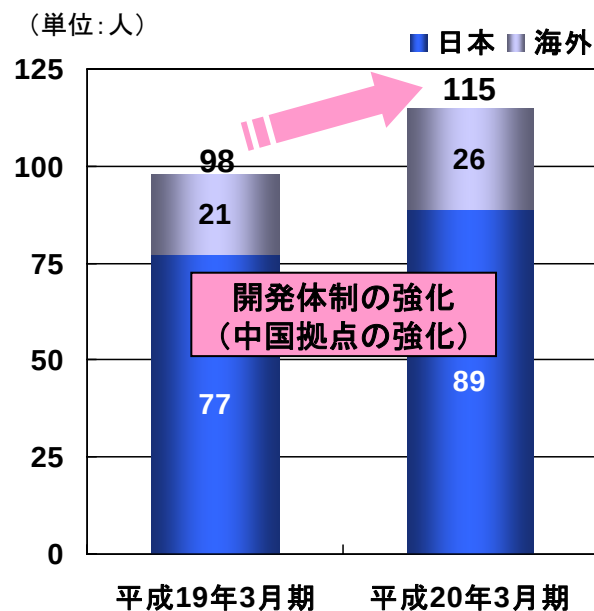
(単位: %)



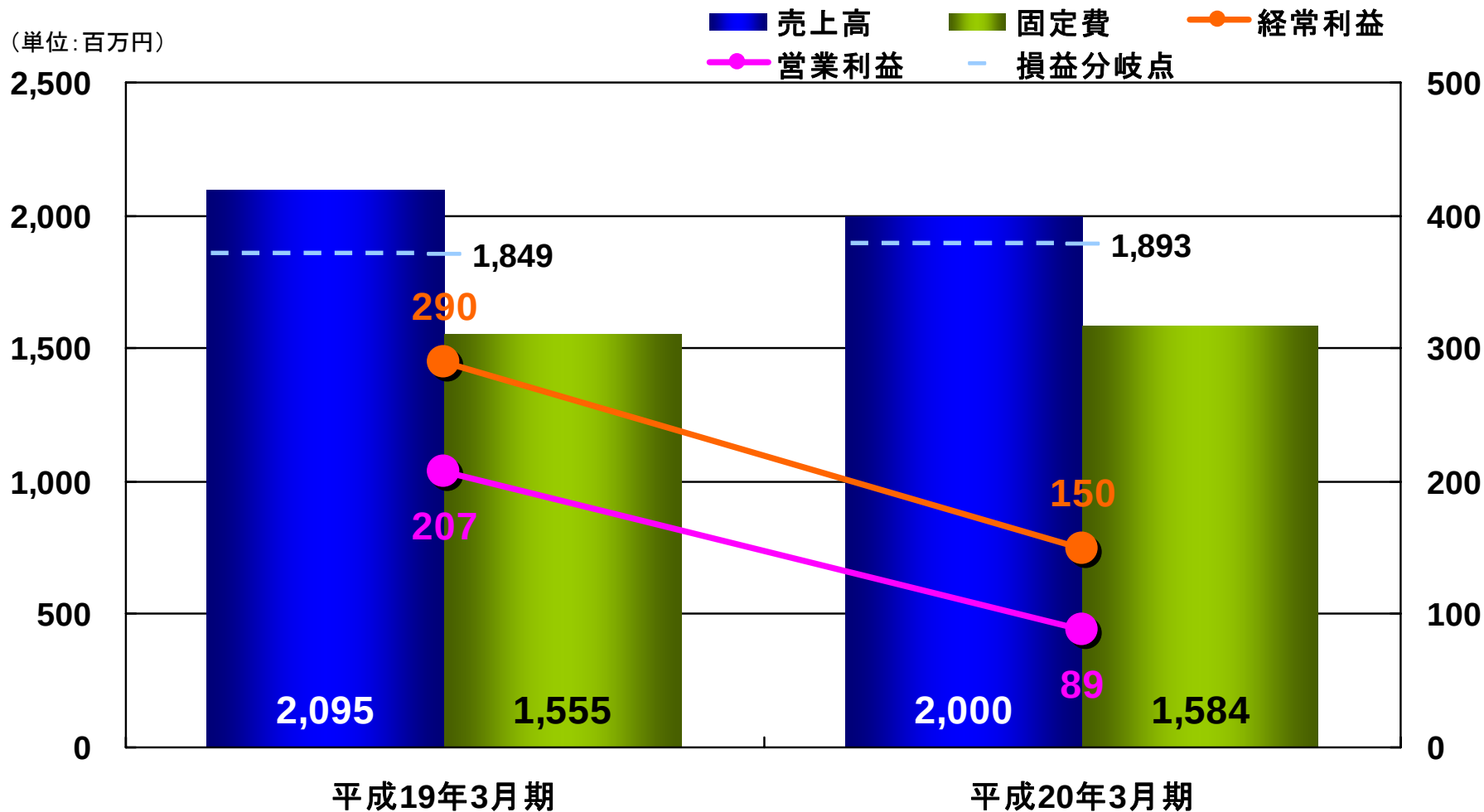
固定費内訳推移(連結)



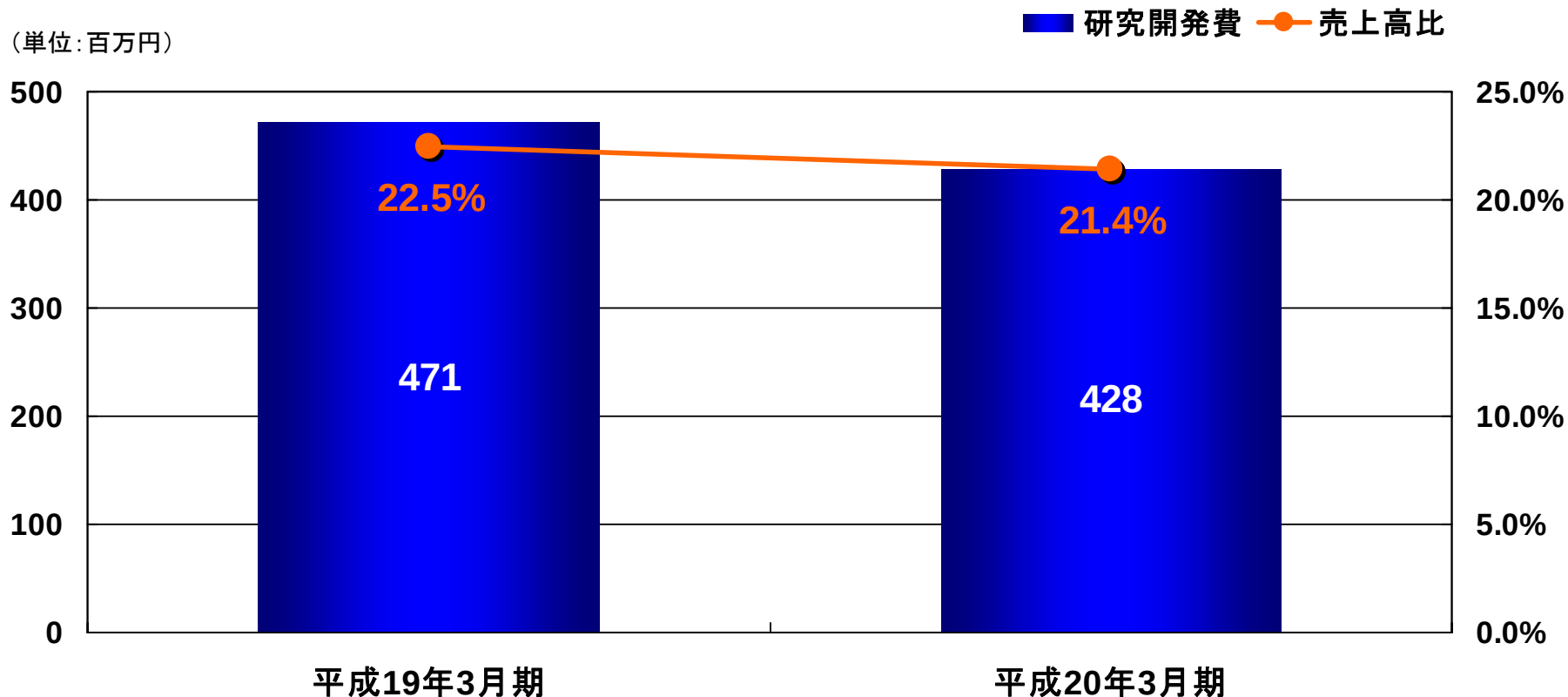
【期末要員数】



売上・利益の推移



研究開発費の推移



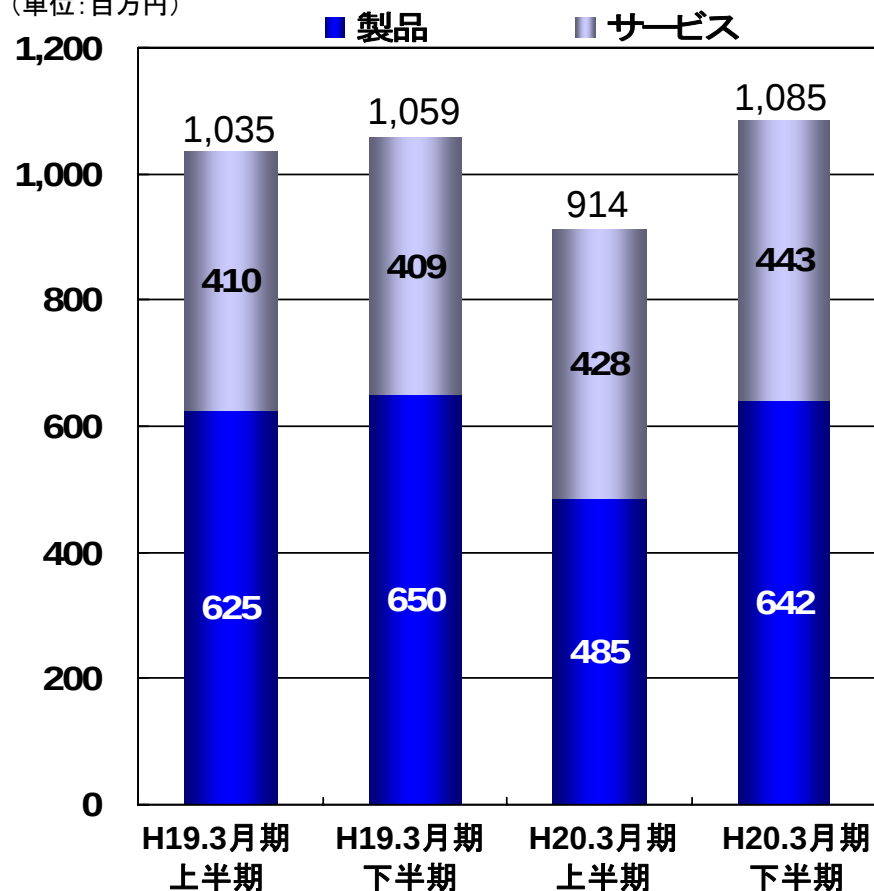
研究開発助成金によるプロジェクトが2テーマから1テーマへと減少しております。
それに合わせて、開発体制を見直しました。

アナログ設計分野 研究開発
DFM分野 研究開発

売上の半期トレンド

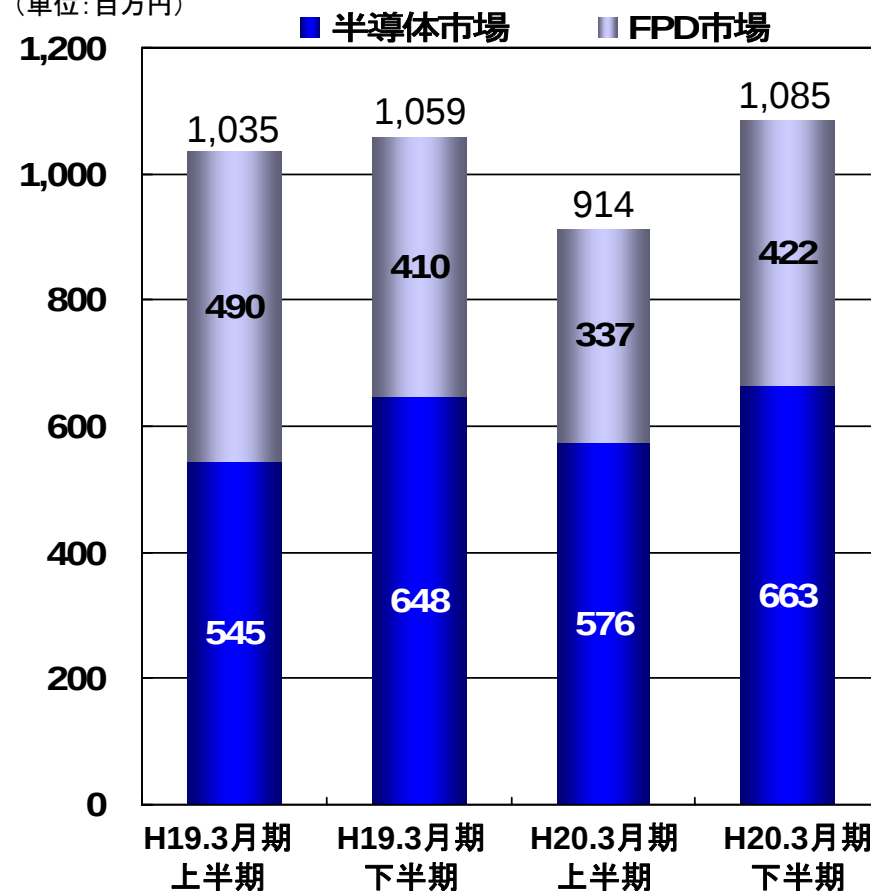
【製品/サービス別】

(単位: 百万円)



【半導体市場/FPD市場別】

(単位: 百万円)



下期売上達成のための重点施策

1. 「JEDAT EDAPair 2007」による販売促進

プライベートショウを大阪(10/17)、東京(10/19)で開催
来場者数が昨年比:16%増を達成
技術セミナーや製品デモも非常に好評で、問い合わせも活発
《重点販売対象》

(1) 当社製品 α -SXシリーズによる設計工数短縮の提案

- ・新製品: IsmoVp(Ismo Valuable Package)
- ・Re-Use(設計資産再利用)の提案

(2) 顧客事例発表

- ・NECエレクトロニクス株式会社 殿: α -SXの事例
- ・株式会社ルネサステクノロジ 殿: HOTSCOPEの事例

(3) 代理販売新製品発表

- ・Orora社: アナログ回路設計効率化製品
- ・Legend社: 高速高精度回路シミュレータ製品: Turbo-MSIM



上期比、売上増約60百万円



JEDAT EDAPair2007 セミナー会場の様子



JEDAT EDAPair2007 デモ会場の様子

下期売上達成のための重点施策

2. 海外市場の販売強化

(1) FPD海外市場の販売強化加速

- ・韓国、中国の代理店支援強化、サポート体制強化、カスタムソフト開発機能強化
- ・重点顧客にフォーカスした営業活動

(2) HOTSCOPE製品の海外市場の拡大

- ・地域別代理店の整備(従来のアジア、米国に加えて欧州)



上期比、売上増約70百万円

3. 新規市場、新規事業の加速

(1) TAKUMI社製品およびCMP-Designer製品による、DFM市場の売上拡大

(2) A-ソリューションによる、アナログIP製品市場への進出



上期比、売上増約40百万円

1.平成20年3月期 中間決算概要

2.平成20年3月期（通期）業績予想

3.今後の事業方針

今後の事業方針(営業開始～はじめの3年)

はじめの3年:

特に

R&Dの強化

主力製品 α -SX

産学官連携

中国R&D設立

R&D要員増

ジーダット営業開始:平成16年2月2日

フルカスタムデザイン分野

へのフォーカス

→No.1製品の追求

ルール・ドリブン設計環境

ネット・ドリブン設計環境

設計制約・ドリブン設計環境

設計の自動化

クリティカル・パス設計環境

フィジカルイメージ・プランナ

設計TAT1/2の実現、さらに1/3へ

今後の事業方針(次の3年)

次の3年:
将来 & 世界を
にらんだ
事業運営

IPO／JASDAQ:平成19年3月15日

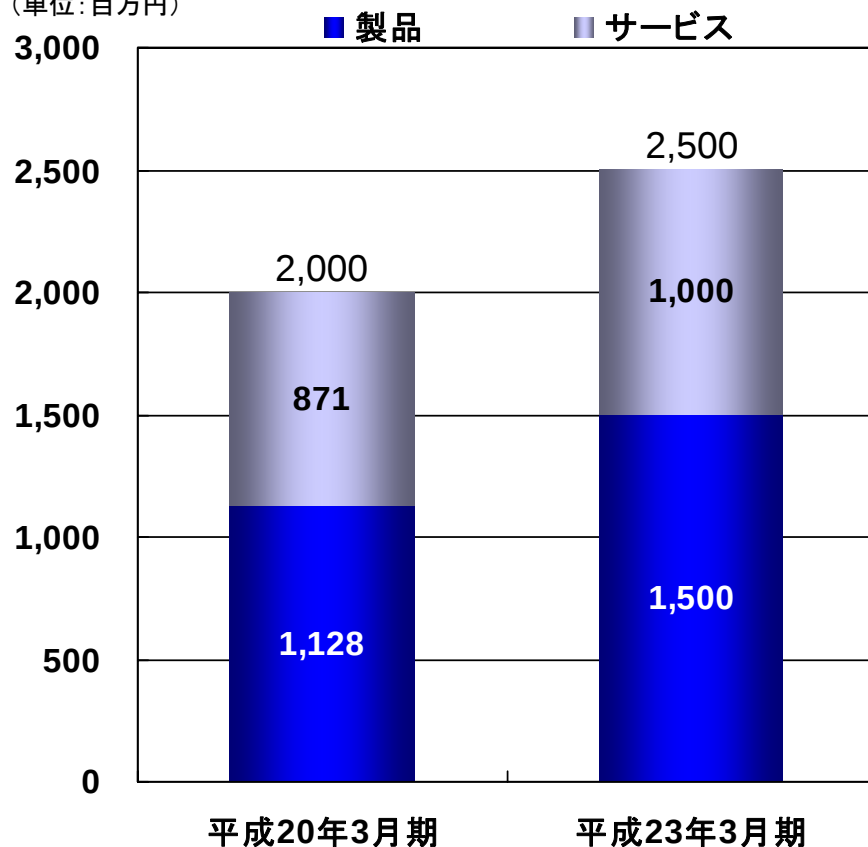
- * 財務健全性の持続
→利益重視
(経常利益5億円、経常利益率20%を目指す)
- * 専門性の追求、ユーザ視点の強化
→A-Solutionの設立
- * グローバル化へ向けて
→戦略的ポイントツールの開発
→他社との連携強化:
(事例)Takumiへの出資
→共存性・互換性の強化:
世界標準化への参画
→Jedat Linkage Program

当事業年度はこの基盤作りの年

3年後の売上構成のイメージ

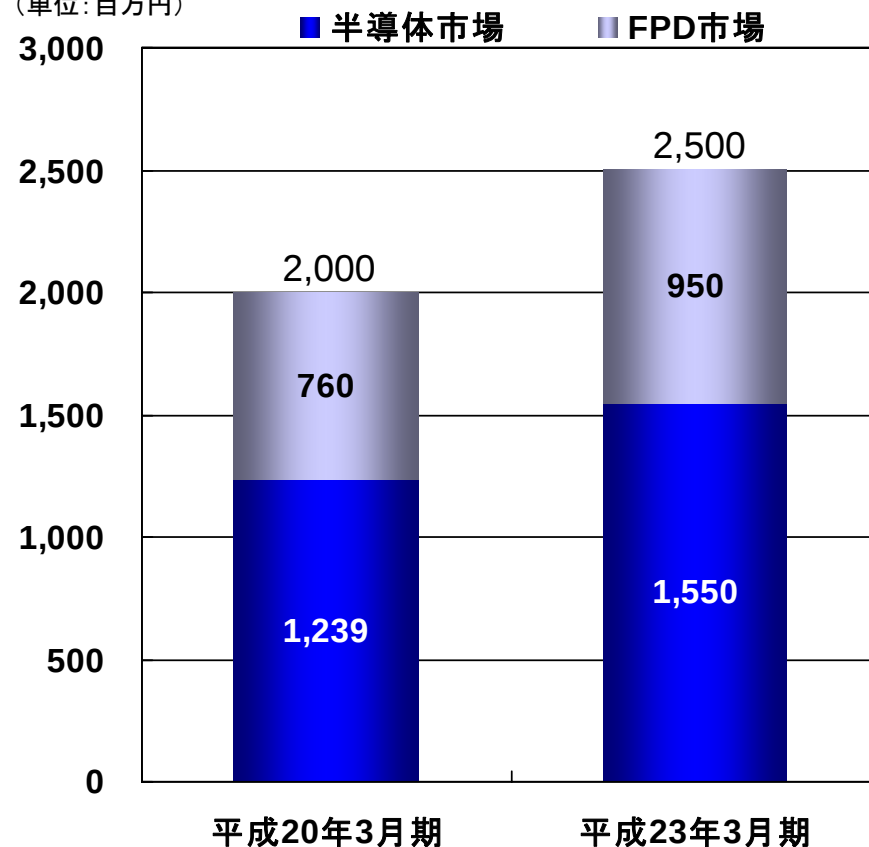
【製品/サービス別】

(単位: 百万円)



【半導体市場/FPD市場別】

(単位: 百万円)



3年後へ向けての販売戦略

1. 対顧客戦略

特定顧客との特別関係構築(個別共同開発、標準ツール化、モデル設計フロー、個別問題解決)

➡ 今期比、売上増250百万円

2. 対市場戦略

(1) 半導体市場

- ・戦略的ポイントツール(新製品)の市場投入
- ・A-ソリューション社によるIP事業の拡大
- ・シナジー効果による専門性・顧客提案力の追求

➡ 今期比、売上増200百万円

(2) 海外市場

FPD向け製品、HOTSCOPE製品の販売拡大

➡ 今期比、売上増200百万円

(3) DFM市場

Takumi製品、CMP-Designerの販売拡大

➡ 今期比、売上増200百万円

ご清聴有難うございました